

超配（维持）

AI、国产替代双轮驱动，板块 Q2 业绩同比高增

半导体行业 2025 年半年报业绩综述

2025 年 9 月 4 日

投资要点：

分析师：刘梦麟

SAC 执业证书编号：

S0340521070002

电话：0769-22110619

邮箱：

liumenglin@dgzq.com.cn

分析师：陈伟光

SAC 执业证书编号：

S0340520060001

电话：0769-22119430

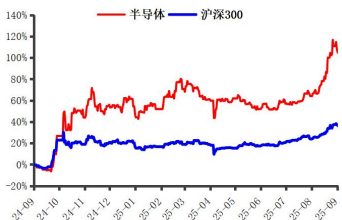
邮箱：

chenweiguang@dgzq.com.cn

■ 半导体行业整体业绩：周期上行，板块Q2营收、归母净利润实现同比、环比增长。半导体行业2025年上半年营业收入3186.09亿元，同比+15.54%，实现归母净利润241.59亿元，同比+32.41%；半导体板块25Q2实现营收1700.23亿元，同比+15.17%，环比+14.43%，实现归母净利润148.25亿元，同比+30.91%，环比+58.82%。盈利能力方面，半导体板块25H1销售毛利率和净利率分别为26.74%和7.37%，相比上年同期分别提高1.98和1.55个百分点，25Q2销售毛利率和净利率分别为27.12%和8.33%，相比上年同期分别提高1.69和1.22个百分点。受益AI驱动上游算力、下游终端需求增长，叠加设备、材料、算力芯片、存储芯片等关键领域国产替代持续推进，2025年二季度国内半导体板块业绩整体表现较好，营收、净利润实现同、环比增长，且盈利能力有所提升。库存方面，截至二季度末，半导体板块存货周转天数为173.78天，同比提高但环比下降，随着下半年电子行业传统旺季到来，板块存货周转情况有望继续环比改善。

■ 细分板块业绩：1）半导体设备：多品类设备自主可控进程加速，板块Q2业绩实现同比、环比增长。半导体设备板块25H1实现营收389.23亿元，同比+30.86%，实现归母净利润63.06亿元，同比+18.84%；板块25Q2实现营收210.38亿元，同比+28.80%，环比+17.62%，实现归母净利润37.41亿元，同比+15.46%，环比+45.87%。2025年上半年国内晶圆厂建厂潮持续，且多品类半导体设备自主化进程加速，半导体设备板块业绩表现亮眼，营收、归母净利润同比提升。展望下半年，内资晶圆厂扩产确定性较强，AI芯片、存储芯片、先进封装等环节国产替代空间广阔，半导体设备作为半导体产业链的基石有望受益；2）半导体材料：Q2营收实现同比增长，部分产品价格承压导致利润同比下滑。半导体材料板块25H1实现营收224.16亿元，同比+11.73%，实现归母净利润14.37亿元，同比+8.81%；板块25Q2实现营收117.62亿元，同比+12.20%，环比+10.40%，实现归母净利润7.14亿元，同比-9.58%，环比-1.33%。2025年上半年内资晶圆厂建厂潮持续，拉动上游半导体材料消耗，带动材料板块营收实现同比增长，然而，受部分企业持续扩产导致折旧摊销成本增加、新产线尚未完全释放业绩、部分产品竞争加剧等因素影响，半导体材料板块2025年二季度净利润同、环比有所下滑；3）数字芯片：人工智能需求强劲，上游算力、下游终端驱动业绩增长。数字芯片板块25H1实现营收871.29亿元，同比+24.72%，实现归母净利润90.50亿元，同比+35.52%；板块25Q2实现营收491.63亿元，同比+28.68%，环比+29.49%，实现归母净利润57.94亿元，同比+45.30%，环比+77.94%。报告期内人工智能需求强劲，上游AI算力、下游AI终端驱动板块业绩实现同比增长。算力方面，报告期内算力芯片的国产替代进程加速，以寒武纪、海光信息为代表的AI芯片企业25Q2业绩实现同比大幅提升，终端方面，以AI眼镜为代表的AI终端出货量同比大幅提高，乐鑫科技、瑞芯微、恒玄科技等终端SoC企业Q2业绩均表现强劲。存储方面，受益海外大厂减产效应，存储器价格二季度有所回暖，相关企业Q2营收、净利润大多实现环比改善；4）模拟芯片：下游应用领域需求复苏，板块Q2业绩实现同比、环比增长。模拟芯片板块25H1实现营收245.02亿元，同比+13.16%，实现归母净利

半导体行业（申万）指数走势



资料来源：东莞证券研究所，iFind

相关报告

本报告的风险等级为中高风险。

本报告的信息均来自已公开信息，关于信息的准确性与完整性，建议投资者谨慎判断，据此入市，风险自担。

请务必阅读末页声明。

润5.03亿元，同比+280.46%；板块25Q2实现营收135.82亿元，同比+17.66%，环比+24.38%，实现归母净利润4.20亿元，同比+70.90%，环比+408.87%。2025年上半年消费电子持续复苏，且通信、工业、汽车等领域需求有所回暖，叠加业内厂商积极推进库存去化，带动模拟芯片行业景气转暖，业内主要企业25Q2营收、归母净利润均实现同比、环比提升。此外，以圣邦、纳芯微为代表的部分企业在工业、车规级芯片等领域加速国产替代，市场份额有所提升；5) **半导体封测：25H1封测行业景气度稳步回升，AI加大先进封装需求。**半导体封测板块25H1实现营收458.64亿元，同比+18.73%，实现归母净利润15.42亿元，同比+3.50%；板块25Q2实现营收239.67亿元，同比+14.28%，环比+9.46%，实现归母净利润11.11亿元，同比+1.81%，环比+157.85%。2025年上半年，全球半导体市场呈现周期复苏，手机芯片、汽车芯片等国产化速度加快，得益于半导体行业景气度整体回升，封测市场需求稳步提升，带动板块25Q2营收、归母净利润实现同比、环比增长。此外，人工智能、智能汽车等新兴应用对封装技术提升更高要求，驱动先进封装占比提升，板块盈利能力有望持续改善；6) **集成电路制造：主要晶圆厂产能利用率稳步提升，板块营收、净利润实现同比增长。**集成电路制造板块25H1实现营收551.29亿元，同比+19.37%，实现归母净利润28.14亿元，同比+44.65%；板块25Q2实现营收278.57亿元，同比+16.14%，环比+2.14%，25Q2实现归母净利润14.22亿元，同比+9.33%，环比+2.12%。根据Trendforce集邦咨询最新调查，因国内市场消费补贴引发的提前备货效应，以及下半年智能手机、笔电/PC、Server新品所需带动，全球整体晶圆代工产能利用率与出货量转强，全球前十晶圆代工工厂2025年二季度合计营收达417.18亿美元，创历史新高，环比增长14.6%。其中，中芯国际、华虹集团25Q2营收分别为22.09亿美元、10.61亿美元，分列全球第三位、第六位。

- **投资策略：AI、国产替代双轮驱动，维持对板块超配评级。**2025年上半年半导体行业处于上行周期，人工智能、国产替代双轮驱动板块Q2营收、归母净利润实现同比增长，且盈利能力有所提高。展望下半年，人工智能需求仍然旺盛，内资晶圆厂先进制程扩产持续推进，而设备、材料、AI算力、存储等领域国产替代进程有望继续深化，龙头企业有望通过并购重组与H股上市加快资源整合，进一步增强综合竞争力。
- **风险提示：**贸易形势不确定性导致下游需求存在不确定性的风险、国产替代进程不及预期的风险、产能持续释放导致竞争加剧的风险等。

目录

1. 半导体行业整体业绩：周期上行，AI、国产替代双轮驱动板块业绩增长	5
2. 子板块业绩情况	7
2.1 半导体设备：多品类设备自主可控进程加速，板块 Q2 业绩实现同比、环比增长	7
2.2 半导体材料：Q2 营收实现同比增长，部分产品价格承压导致利润同比下滑	9
2.3 数字芯片：人工智能需求强劲，上游算力、下游终端驱动业绩增长	11
2.3 模拟芯片：下游应用领域需求复苏，板块 Q2 业绩实现同比、环比增长	14
2.4 半导体封测：25H1 封测行业景气度稳步回升，AI 加大先进封装需求	16
2.5 集成电路制造：主要晶圆厂产能利用率稳步提升，板块营收、净利润实现同比增长	18
3. 投资建议	20
4. 风险提示	21

插图目录

图 1：半导体板块 2021H1-2025H1 营收情况	5
图 2：半导体板块 2021H1-2025H1 归母净利润情况	5
图 3：半导体板块 2021Q2-2025Q2 营收情况	5
图 4：半导体板块 2021Q2-2025Q2 归母净利润情况	5
图 5：半导体板块 2021H1-2025H1 毛利率、净利率（%）	5
图 6：半导体板块 2021Q2-2025Q2 毛利率、净利率	5
图 7：半导体板块报告期末存货周转天数（2022Q1-2025Q2）	6
图 8：全球半导体月度销售情况	6
图 9：中国半导体月度销售情况	6
图 10：半导体设备板块 2021H1-2025H1 营收情况	7
图 11：半导体设备板块 2021H1-2025H1 归母净利润情况	7
图 12：半导体设备板块 2021Q2-2025Q2 营收情况	7
图 13：半导体设备板块 2021Q2-2025Q2 归母净利润情况	7
图 14：半导体设备板块 2021H1-2025H1 毛利率、净利率（%）	8
图 15：半导体设备板块 2021Q2-2025Q2 毛利率、净利率	8
图 16：半导体材料板块 2021H1-2025H1 营收情况	9
图 17：半导体材料板块 2021H1-2025H1 归母净利润情况	9
图 18：半导体材料板块 2021Q2-2025Q2 营收情况	9
图 19：半导体材料板块 2021Q2-2025Q2 归母净利润情况	9
图 20：半导体材料板块 2021H1-2025H1 毛利率、净利率（%）	10
图 21：半导体材料板块 2021Q2-2025Q2 毛利率、净利率	10
图 22：数字芯片板块 2021H1-2025H1 营收情况	11
图 23：数字芯片板块 2021H1-2025H1 归母净利润情况	11
图 24：数字芯片板块 2021Q2-2025Q2 营收情况	12
图 25：数字芯片板块 2021Q2-2025Q2 归母净利润情况	12
图 26：数字芯片板块 2021H1-2025H1 毛利率、净利率（%）	12
图 27：数字芯片板块 2021Q2-2025Q2 毛利率、净利率	12
图 28：模拟芯片板块 2021H1-2025H1 营收情况	14
图 29：模拟芯片板块 2021H1-2025H1 归母净利润情况	14
图 30：模拟芯片板块 2021Q2-2025Q2 营收情况	14

图 31：模拟芯片板块 2021Q2-2025Q2 归母净利润情况	14
图 32：模拟芯片板块 2021H1-2025H1 毛利率、净利率 (%)	15
图 33：模拟芯片板块 2021Q2-2025Q2 毛利率、净利率	15
图 34：半导体封测板块 2021H1-2025H1 营收情况	16
图 35：半导体封测板块 2021H1-2025H1 归母净利润情况	16
图 36：半导体封测板块 2021Q2-2025Q2 营收情况	16
图 37：半导体封测板块 2021Q2-2025Q2 归母净利润情况	16
图 38：半导体封测板块 2021H1-2025H1 毛利率、净利率 (%)	17
图 39：半导体封测板块 2021Q2-2025Q2 毛利率、净利率	17
图 40：集成电路制造板块 2021H1-2025H1 营收情况	18
图 41：集成电路制造板块 2021H1-2025H1 归母净利润情况	18
图 42：集成电路制造板块 2021Q2-2025Q2 营收情况	18
图 43：集成电路制造板块 2021Q2-2025Q2 归母净利润情况	18
图 44：集成电路制造板块 2021H1-2025H1 毛利率、净利率 (%)	19
图 45：集成电路制造板块 2021Q2-2025Q2 毛利率、净利率	19
图 46：2025 年二季度全球前十大晶圆代工厂营收排名 (单位：百万美元)	19

表格目录

表 1：重点公司盈利预测及投资评级 (截至 2025/9/3)	21
---------------------------------------	----

1. 半导体行业整体业绩：周期上行，AI、国产替代双轮驱动板块业绩增长

半导体板块整体业绩：周期上行，半导体板块 Q2 营收、净利润实现同比、环比增长。选取申万分类标准下“SW 电子——SW 半导体”的所有上市公司，统计半导体板块 2025 年上半年业绩情况。半导体行业 2025 年上半年营业收入 3186.09 亿元，同比增长 15.54%，实现归母净利润 241.59 亿元，同比增长 32.41%；分季度来看，半导体板块 25Q2 实现营收 1700.23 亿元，同比+15.17%，环比+14.43%，25Q2 实现归母净利润 148.25 亿元，同比+30.91%，环比+58.82%。

图 1：半导体板块 2021H1-2025H1 营收情况

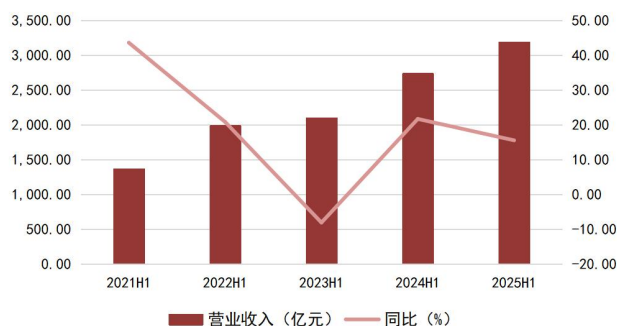
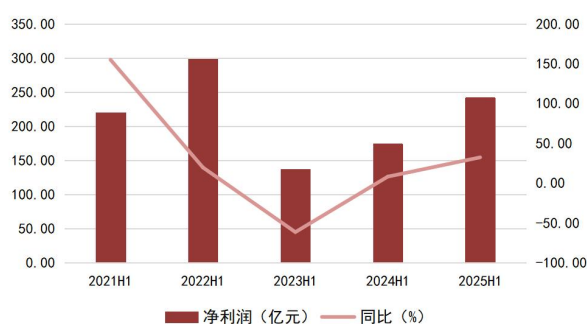


图 2：半导体板块 2021H1-2025H1 归母净利润情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 3：半导体板块 2021Q2-2025Q2 营收情况

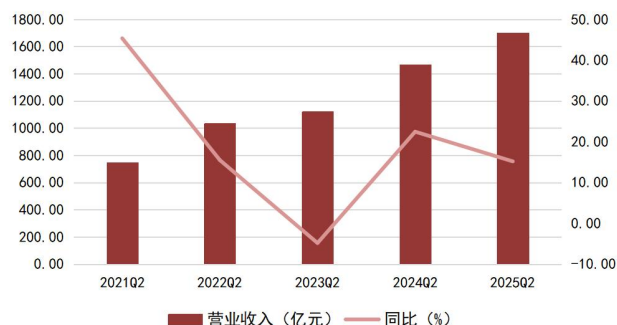
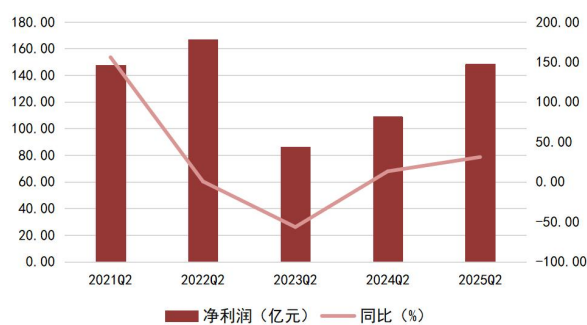


图 4：半导体板块 2021Q2-2025Q2 归母净利润情况

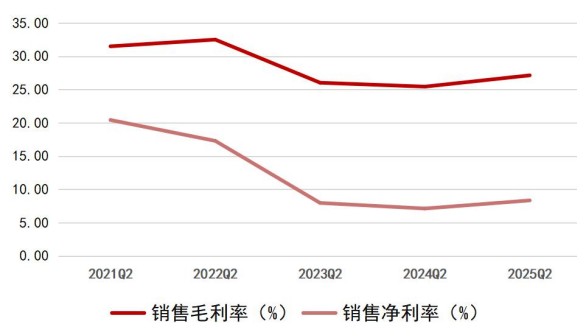
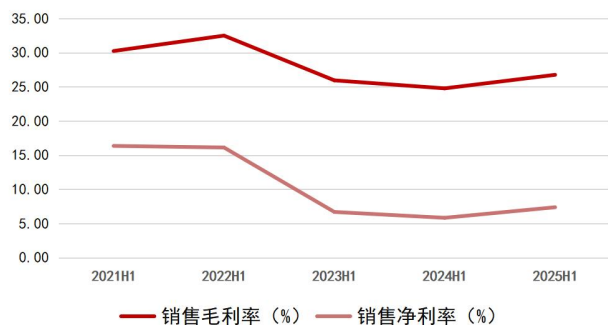


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

盈利能力：板块 25Q2 销售毛利率、净利率实现同比提升。盈利能力方面，申万半导体板块 2025 年上半年销售毛利率和净利率分别为 26.74%和 7.37%，相比上年同期分别提高 1.98 和 1.55 个百分点，2025 年二季度销售毛利率和净利率分别为 27.12%和 8.33%，相比上年同期分别提高 1.69 和 1.22 个百分点。

图 5：半导体板块 2021H1-2025H1 毛利率、净利率 (%) 图 6：半导体板块 2021Q2-2025Q2 毛利率、净利率

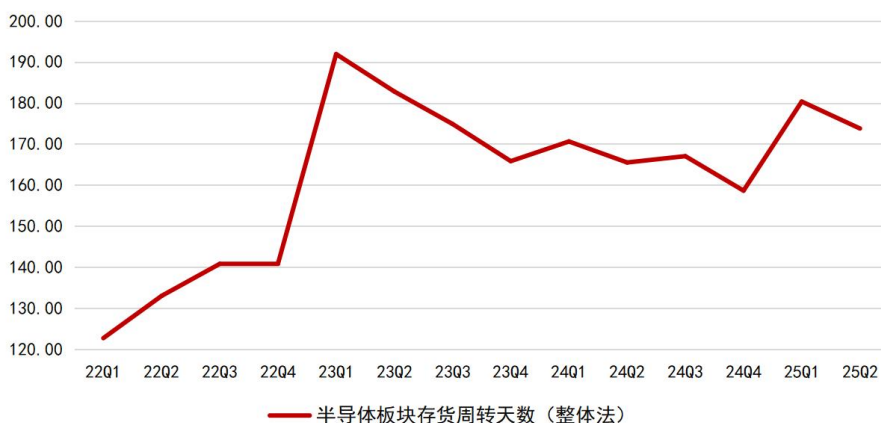


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

存货周转：25Q2 存货周转天数环比有所改善。存货周转方面，半导体板块存货周转天数从 21Q1 开始逐步上行，至 23Q1 达到高点，后续逐步改善。截至 25Q2 末，半导体板块存货周转天数为 173.78 天，相比上年同期增加 8.29 天，环比 25Q1 下降 6.56 天。随着业内厂商持续推进库存去化，2025 年下半年板块存货周转情况有望继续改善。

图 7：半导体板块报告期末存货周转天数（2022Q1-2025Q2）

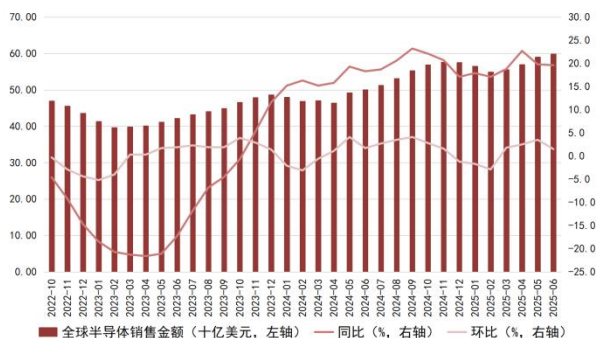


数据来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

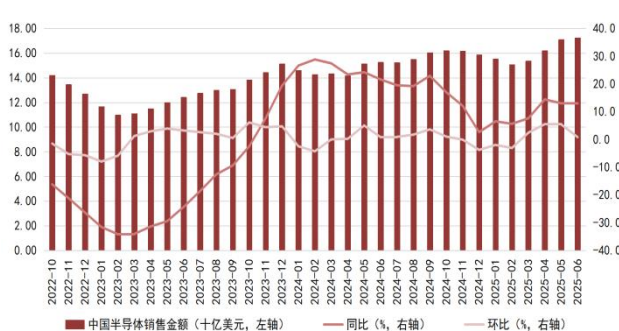
半导体半年度销售情况：行业周期上行，2025 年 1-6 月全球、国内半导体销售额实现同比增长。根据美国半导体产业协会（SIA）数据，受益以人工智能为代表的新兴应用拉动需求，2025 年上半年全球、国内半导体销售额实现同比增长。具体而言，2025 年 1-6 月全球半导体销售额为 3429.1 亿美元，同比增长 19.21%，国内半导体销售额为 965.0 亿美元，同比增长 10.01%。

图 8：全球半导体月度销售情况

图 9：中国半导体月度销售情况



资料来源：美国半导体产业协会，东莞证券研究所



资料来源：美国半导体产业协会，东莞证券研究所

综上所述，受益 AI 驱动上游算力、下游终端需求增长，叠加设备、材料、算力芯片、存储芯片等关键领域国产替代持续推进，2025 年二季度国内半导体板块业绩整体表现较好，营收、净利润实现同比、环比增长，且盈利能力有所提升。库存方面，截至二季度末，半导体板块存货周转天数为 173.78 天，同比提高但环比下降，随着下半年电子行业传统旺季到来，板块存货周转情况有望继续环比改善。

2. 子板块业绩情况

2.1 半导体设备：多品类设备自主可控进程加速，板块 Q2 业绩实现同比、环比增长

选取申万半导体行业下的三级行业——“半导体设备”作为半导体设备代表，统计板块 2025 年上半年业绩情况。

板块业绩：国产替代持续推进，半导体设备板块 25Q2 营收、归母净利润实现同比、环比增长。半导体设备板块 2025 年上半年实现营收 389.23 亿元，同比+30.86%，实现归母净利润 63.06 亿元，同比+18.84%；分季度来看，板块 25Q2 实现营收 210.38 亿元，同比+28.80%，环比+17.62%，板块 25Q2 实现归母净利润 37.41 亿元，同比+15.46%，环比+45.87%。

图 10：半导体设备板块 2021H1-2025H1 营收情况

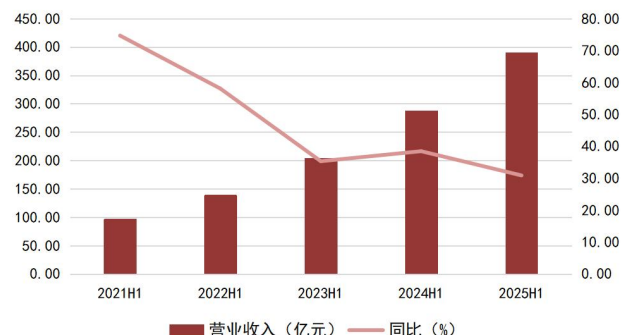
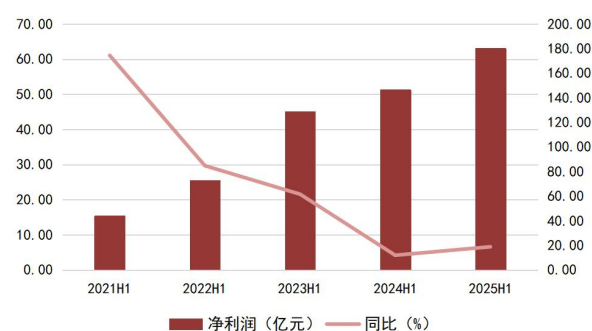


图 11：半导体设备板块 2021H1-2025H1 归母净利润情况

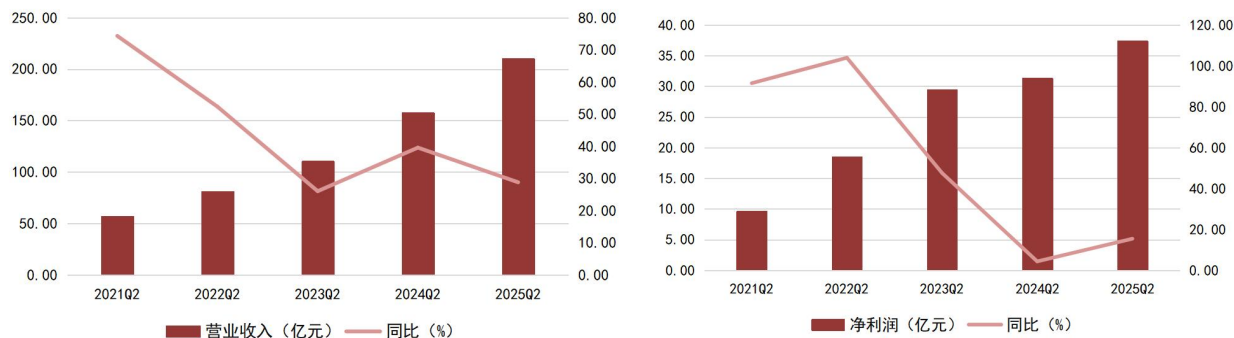


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 12：半导体设备板块 2021Q2-2025Q2 营收情况

图 13：半导体设备板块 2021Q2-2025Q2 归母净利润情况

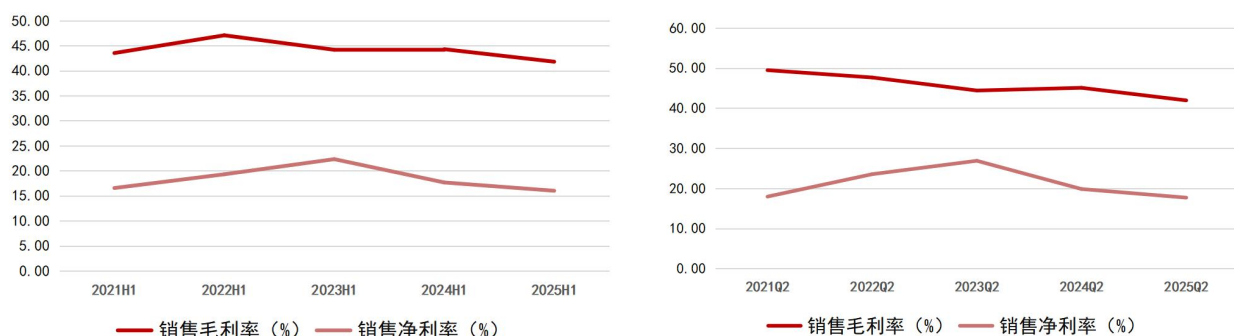


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

25Q2 盈利能力同比略有下滑。半导体设备板块 2025 年上半年销售毛利率、销售净利率分别为 41.79%和 16.00%，相比上年同期分别下降 2.50 和 1.66 个百分点，板块 25Q2 销售毛利率和净利率分别为 41.93%和 17.68%，相比上年同期分别下降 3.14 和 2.15 个百分点，报告期内销售毛利率和净利率同比略有下滑。

图 14：半导体设备板块 2021H1-2025H1 毛利率、净利率图 15：半导体设备板块 2021Q2-2025Q2 毛利率、净利率



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

综上所述,2025 年上半年国内晶圆厂建厂潮持续,且多品类半导体设备自主化进程加速,半导体设备板块业绩表现亮眼,营收、归母净利润同比提升。展望下半年,内资晶圆厂扩产确定性较强,AI 芯片、存储芯片、先进封装等环节国产替代空间广阔,半导体设备作为半导体产业链的基石有望受益。

部分半导体设备企业业绩梳理

北方华创（002371）：公司 2025 年上半年实现营收 161.42 亿元，同比+29.51%，实现归母净利润 32.08 亿元，同比+14.97%，对应 25Q2 营收为 79.36 亿元，同比+21.84%，环比-3.30%，对应 25Q2 归母净利润为 16.27 亿元，同比-1.47%，环比+2.95%。报告期内，公司业绩实现稳健增长，平台化布局稳步推进，并持续以高强度研发投入与专利布局巩固技术领先地位。2025 年上半年，公司研发投入达 29.15 亿元，同比增长 30.01%，累计申请专利 9900 余件，授权专利 5700 余件，稳居国内集成电路装备企业首位。

中微公司（688012）：公司 2025 年上半年实现营收 49.61 亿元，同比+43.88%，实现归母净利润 7.06 亿元，同比+36.62%，对应 25Q2 营收为 27.87 亿元，同比+51.26%，环比+28.25%，对应 25Q2 归母净利润为 3.93 亿元，同比+46.82%，环比+25.47%。2025 年上半年，公司刻蚀设备、薄膜沉积设备持续放量，在手订单实现高速增长。研发投入方面，公司 2025 年上半年研发投入为 14.92 亿元，同比增长 53.70%，占营收比重达 30.07%，高于行业平均水平。

华海清科（688120）：公司 2025 年上半年实现营收 19.50 亿元，同比+30.28%，实现归母净利润 5.05 亿元，同比+16.82%，对应 25Q2 营收为 10.37 亿元，同比+27.05%，环比+13.65%，对应 25Q2 归母净利润为 2.72 亿元，同比+18.01%，环比+16.53%。2025 年上半年，公司收入实现同比快速增长，主要原因系 CMP 产品市占率持续提高、关键耗材与维保服务逐步放量、晶圆再生与湿法设备收入逐步增加等因素带动。受离子注入等新设备处于投入期，职工薪酬增长较快、利息收入与政府补助下滑等因素影响，公司 2025 年上半年净利润同比增速低于同期营收增速。

2.2 半导体材料：Q2 营收实现同比增长，部分产品价格承压导致利润同比下滑

选取申万半导体行业下的三级行业——“半导体材料”作为半导体材料代表，统计板块 2025 年上半年业绩情况。

板块业绩：半导体材料板块 Q2 增收不增利。半导体材料板块 2025 年上半年实现营收 224.16 亿元，同比+11.73%，实现归母净利润 14.37 亿元，同比+8.81%；分季度来看，板块 25Q2 实现营收 117.62 亿元，同比+12.20%，环比+10.40%，25Q2 实现归母净利润 7.14 亿元，同比-9.58%，环比-1.33%。

图 16：半导体材料板块 2021H1-2025H1 营收情况

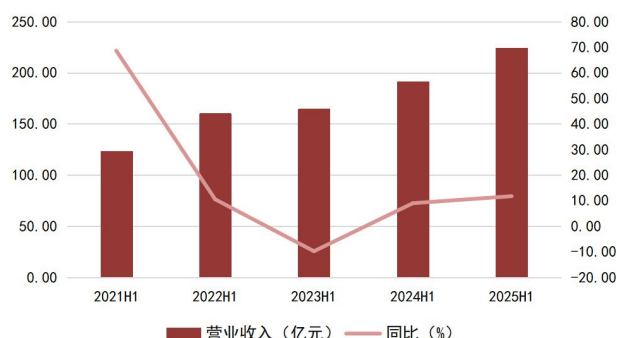
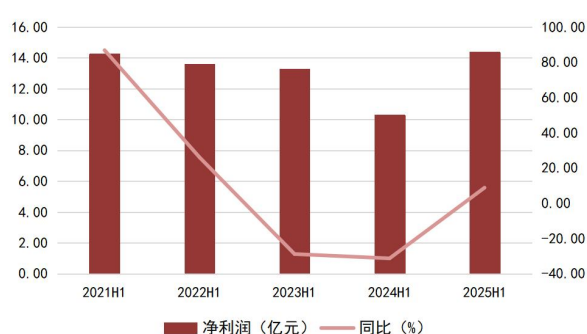


图 17：半导体材料板块 2021H1-2025H1 归母净利润情况

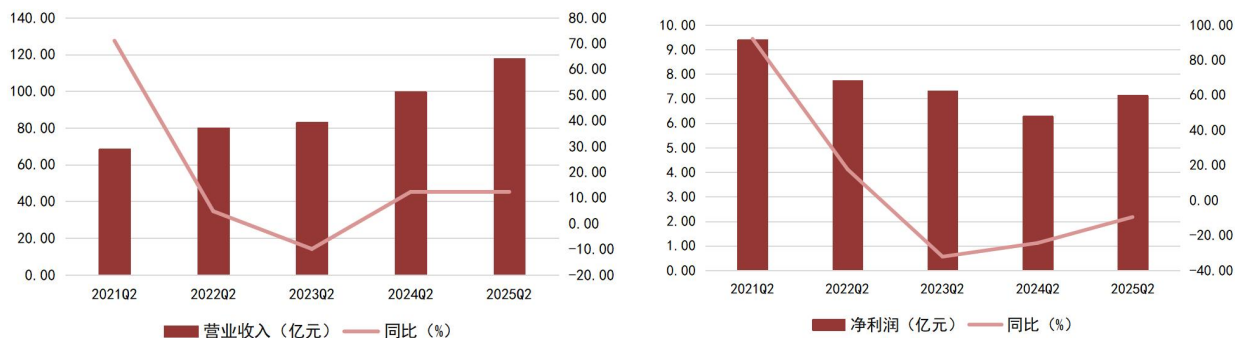


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 18：半导体材料板块 2021Q2-2025Q2 营收情况

图 19：半导体材料板块 2021Q2-2025Q2 归母净利润情况

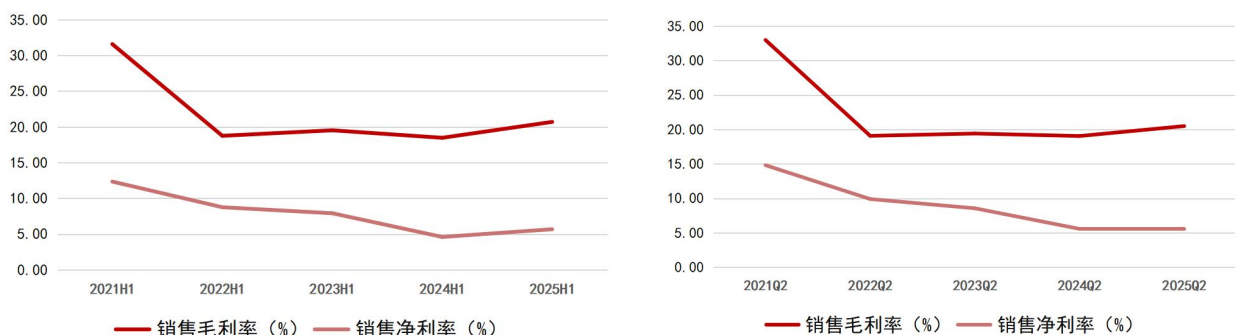


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

盈利能力：Q2 销售毛利率同比提升，净利率基本持平。盈利能力方面，半导体材料板块 2025 年上半年销售毛利率、销售净利率分别为 20.69%和 5.68%，相比上年同期分别提高 2.22pct 和 1.08pct，板块 25Q2 销售毛利率为 20.48%，同比提高 1.44pct，销售净利率为 5.52%，同比下降 0.06pct。

图 20：半导体材料板块 2021H1-2025H1 毛利率、净利率图 21：半导体材料板块 2021Q2-2025Q2 毛利率、净利率 (%)



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

综上所述，2025 年上半年内资晶圆厂建厂潮持续，拉动上游半导体材料消耗，带动半导体材料板块营收实现同比增长，然而，受部分企业持续扩产导致折旧摊销成本增加、新产线尚未完全释放业绩、部分产品竞争加剧等因素影响，半导体材料板块 2025 年二季度净利润同比、环比有所下滑。

部分半导体材料企业业绩梳理

江丰电子（300666）：公司 2025 年上半年实现营收 20.95 亿元，同比+28.71%，实现归母净利润 2.53 亿元，同比+56.79%，对应 25Q2 营收为 10.94 亿元，同比+27.97%，环比+9.37%，对应 25Q2 归母净利润为 0.95 亿元，同比-5.96%，环比-39.30%。报告期内，公司传统主业超高纯溅射靶材实现稳步增长，2025 年上半年实现营收 13.25 亿元，同比

增长 23.91%，占营收比重为 63.25%；半导体精密零部件业务持续放量，2025 年上半年实现营收 4.59 亿元，同比增长 15.12%，占营收比重 21.91%，打造第二成长曲线。盈利能力方面，2025 年上半年公司超高纯溅射靶材业务毛利率为 33.26%，同比提高 2.93pct，精密零部件业务毛利率为 23.65%，同比下降 10.99pct，主要系该业务仍处于发展初期且投入较大所致。

鼎龙股份（300054）：公司 2025 年上半年实现营收 17.32 亿元，同比+14.00%，实现归母净利润 3.11 亿元，同比+42.78%，对应 25Q2 营收为 9.08 亿元，同比+11.94%，环比+10.17%，对应 25Q2 归母净利润为 1.70 亿元，同比+24.79%，环比+20.61%。报告期内，公司半导体业务营收达 9.43 亿元，占总营收比重达 54.75%。CMP 抛光垫方面，2025 年上半年实现营收 4.75 亿元，同比增长 59.58%，其中 Q2 营收达到 2.65 亿元，创历史新高，市场渗透率持续加深；CMP 抛光液及清洗液方面，2025 年上半年实现营收 1.19 亿元，同比增长 55.22%，并获得主流逻辑晶圆厂客户认可；高端晶圆光刻胶业务方面，截至 2025 年 6 月底公司已布局近 30 款，浸没式 ArF 及 KrF 晶圆光刻胶业务持续推进，超过 15 款产品已送样客户验证，其中超过 10 款进入加仑样测试阶段。

雅克科技（002409）：公司 2025 年上半年实现营收 42.93 亿元，同比增长 31.82%，实现归母净利润 5.23 亿元，同比增长 0.63%，对应 25Q2 营收为 21.75 亿元，同比+32.76%，环比+2.71%，对应 25Q2 归母净利润为 3.03 亿元，同比+8.09%，环比+12.99%。据公司半年报，2025 年上半年公司半导体化学材料、光刻机及配套试剂实现营收 21.13 亿元，同比增长约 19%，其中前驱体业务 2025 年上半年产品收入增速超 30%，导入长鑫存储、海力士、长江存储、中芯国际、三星、台积电等全球主要客户进程均取得积极进展。

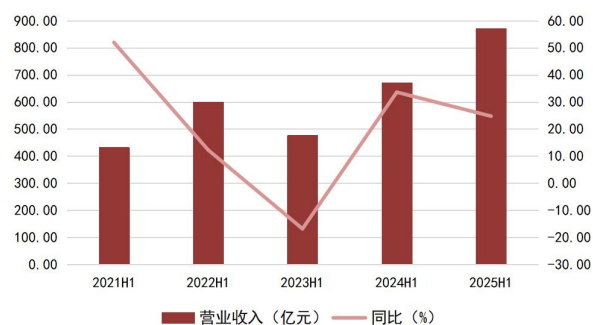
2.3 数字芯片：人工智能需求强劲，上游算力、下游终端驱动业绩增长

选取申万半导体行业下的三级行业——“数字芯片设计”作为数字芯片板块代表，统计板块 2025 年上半年业绩情况。

板块业绩：上游算力国产替代加速，下游终端需求回暖，板块 25Q2 营收、归母净利润实现同比、环比大幅增长。数字芯片板块 2025 年上半年实现营收 871.29 亿元，同比+24.72%，实现归母净利润 90.50 亿元，同比+35.52%；分季度来看，板块 25Q2 实现营收 491.63 亿元，同比+28.68%，环比+29.49%，25Q2 实现归母净利润 57.94 亿元，同比+45.30%，环比+77.94%。

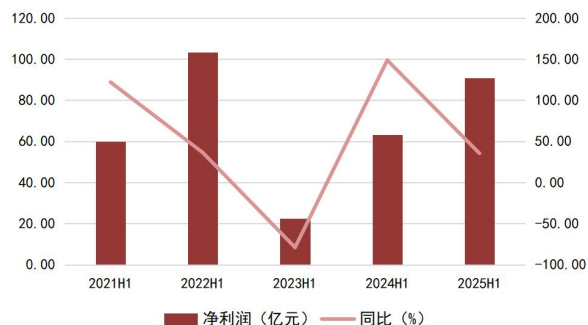
图 22：数字芯片板块 2021H1-2025H1 营收情况

图 23：数字芯片板块 2021H1-2025H1 归母净利润情况



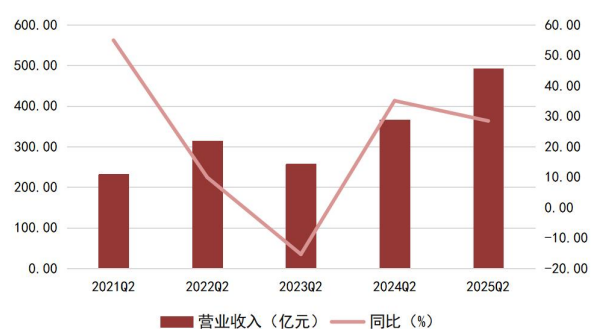
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 24：数字芯片板块 2021Q2-2025Q2 营收情况

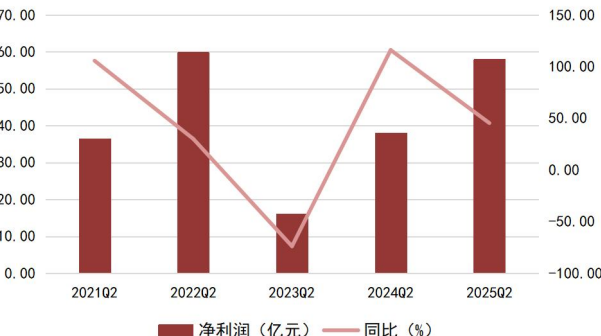


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 25：数字芯片板块 2021Q2-2025Q2 归母净利润情况



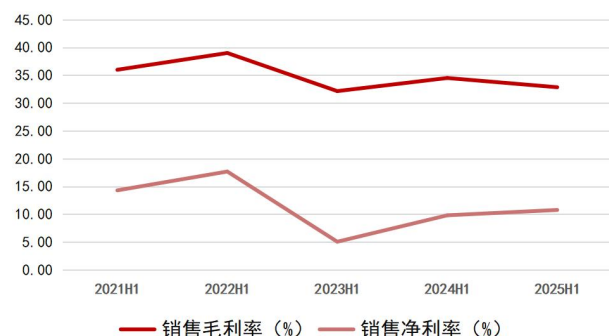
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所



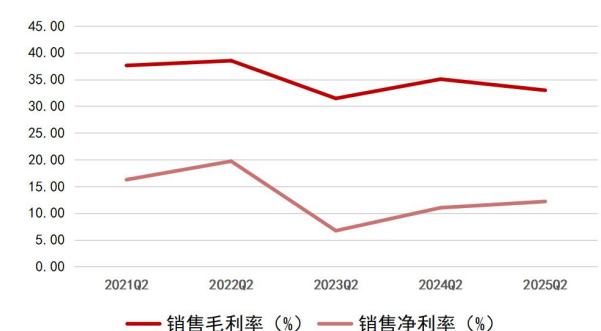
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

盈利能力：25Q2 销售毛利率同比下滑，销售净利率同比提高。盈利能力方面，数字芯片板块 2025 年上半年销售毛利率为 32.84%，同比下降 1.66pct，销售净利率为 10.77%，同比提高 0.96pct，板块 25Q2 销售毛利率为 32.96%，同比下降 2.08pct，销售净利率为 12.16%，同比提高 1.17pct。

图 26：数字芯片板块 2021H1-2025H1 毛利率、净利率 (%)图 27：数字芯片板块 2021Q2-2025Q2 毛利率、净利率



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

综上所述，报告期内人工智能需求强劲，上游 AI 算力、下游 AI 终端驱动板块业绩实现同比增长。算力方面，报告期内算力芯片的国产替代进程加速，以寒武纪、海光信息为代表的 AI 芯片企业 25Q2 业绩实现同比大幅提升，终端方面，以 AI 眼镜为代表的 AI 终端出货量同比大幅提高，乐鑫科技、瑞芯微、恒玄科技等终端 SoC 企业 Q2 业绩均表现强劲。存储方面，受益海外大厂减产效应，存储器价格二季度有所回暖，相关企业 Q2

营收、净利润大多实现环比改善。

部分数字芯片企业业绩梳理

豪威集团（603501）：公司 2025 年上半年实现营收 139.56 亿元，同比增长 15.42%，实现归母净利润 20.28 亿元，同比增长 48.34%，对应 25Q2 营收为 74.84 亿元，同比+16.07%，环比+15.63%，对应 25Q2 归母净利润为 11.62 亿元，同比+43.58%，环比+34.17%。2025 年上半年，公司各项业务实现稳健增长，其中半导体设计业务实现营收 115.72 亿元，同比增长 11.08%，占营收比重为 83.01%，半导体分销业务实现收入 23.14 亿元，同比增长 41.73%，占营收比重为 16.60%。半导体设计业务中，图像传感器解决方案收入为 103.46 亿元，同比增长 11.10%，占营收比重为 74.21%，构成公司主要营收来源。

海光信息（688041）：公司 2025 年上半年实现营收 54.64 亿元，同比增长 45.21%，实现归母净利润 12.01 亿元，同比增长 40.78%，对应 25Q2 营收为 30.64 亿元，同比+41.15%，环比+27.66%，对应 25Q2 归母净利润为 6.96 亿元，同比+23.14%，环比+37.49%。报告期内，国产高端芯片市场需求持续攀升，公司通过深化与整机厂商、生态伙伴的合作，加速在客户端的导入，推动高端处理器产品的市场版图扩展，实现经营业绩的显著增长。

寒武纪（688256）：公司 2025 年上半年实现营收 28.81 亿元，同比增长 4347.82%，实现归母净利润 10.38 亿元，同比增长 295.82%，对应 25Q2 营收为 17.69 亿元，同比+4425.01%，环比+59.09%，对应 25Q2 归母净利润为 6.83 亿元，同比+324.97%，环比+92.03%。2025 年上半年，依托于公司在人工智能芯片产品、基础系统软件平台取得的长足进步，公司产品持续在运营商、金融、互联网等多个重点行业规模化部署并通过了客户严苛环境的验证。报告期内，公司产品持续优化了软硬件平台可靠性及易用性，在大规模商业场景部署下，可长时间保持稳定性。此外，公司产品在各人工智能典型应用场景具有普适性，获得了客户的广泛认可，体现了公司产品的技术领先优势。

兆易创新（603986）：公司 2025 年上半年实现营收 41.50 亿元，同比增长 15.00%，实现归母净利润 5.75 亿元，同比增长 11.31%，对应 2025Q2 营收为 22.41 亿元，同比增长 13.09%，环比增长 17.40%，对应 25Q2 归母净利润为 3.41 亿元，同比增长 9.17%，环比增长 45.27%。盈利能力方面，公司 25Q2 单季度销售毛利率为 37.01%，同比下降 1.14pct，环比下降 0.43pct，销售净利率为 15.53%，同比下降 0.22pct，环比提升 2.97pct。报告期内，受益消费类国家补贴政策实施，消费终端需求稳步释放，此外 AI 发展拉动 PC、服务器、汽车电子等领域需求增长。公司持续保持以市占率为中心的策略，较好地把握了市场机遇，产品在汽车、消费、存储与计算、手机等多个领域实现了收入和销量同比快速增长。同时，利基型 DRAM 行业供给格局改善，带动产品量价齐升。

澜起科技（688008）：公司 2025 年上半年实现营收 26.33 亿元，同比增长 58.17%，实现归母净利润 11.59 亿元，同比增长 95.41%，对应 2025Q2 营收为 14.11 亿元，同比增长 52.12%，环比增长 15.47%，对应 25Q2 归母净利润为 6.34 亿元，同比增长 71.40%，环比增长 20.64%，Q2 单季度营收、归母净利润均创历史新高。分业务来看，2025 年上半年公司互联类芯片、津逮服务器平台收入分别为 24.61 亿元和 1.68 亿元，同比分别增长 61.00%和 28.58%，其中 25Q2 互联类产品收入为 13.21 亿元，同比+58.68%，环比

+16%，创单季度新高。受益 AI 服务器市场高景气，叠加 DDR5 大规模渗透，公司 DDR5 内存接口芯片、内存模组配套芯片显著放量，产品结构持续优化。

乐鑫科技（688018）：公司 2025 年上半年实现营收 12.46 亿元，同比增长 35.35%，实现归母净利润 2.61 亿元，同比增长 72.29%，对应 2025Q2 营收为 6.88 亿元，同比增长 29.02%，环比增长 23.28%，对应 25Q2 归母净利润为 1.68 亿元，同比增长 71.45%，环比增长 78.82%，Q2 单季度营收、归母净利润均创历史新高。报告期内，下游 AIoT 需求旺盛，公司作为物联网领域专业芯片设计及解决方案提供商，一方面受益家居智能化的渗透率不断提升，另一方面芯片产品线持续扩张，如从单 Wi-Fi 芯片发展到目前已涵盖 2.4&5GHz Wi-Fi 6、蓝牙、Thread/Zigbee 等多种连接技术的芯片，因此报告期内经营业绩实现增长。

瑞芯微（603893）：公司 2025 年上半年实现营收 20.46 亿元，同比增长 63.85%，实现归母净利润 5.31 亿元，同比增长 190.61%，对应 2025Q2 营收为 11.61 亿元，同比增长 64.54%，环比增长 31.18%，对应 25Q2 归母净利润为 3.22 亿元，同比增长 179.41%，环比增长 53.56%，公司 Q2 单季度营收、归母净利润均创历史新高。2025 年上半年，AIoT 市场延续增长态势，公司依托在 AIoT 产品长期战略布局优势，顺应 AI 在端侧应用发展需求，旗舰产品 RK3588、次新产品 RK3576 等带领 AIoT 各产品线继续保持高速增长，特别在汽车电子、工业应用、机器视觉及各类机器人等重点领域持续扩张。

2.3 模拟芯片：下游应用领域需求复苏，板块 Q2 业绩实现同比、环比增长

选取申万半导体行业下的三级行业——“模拟芯片设计”作为模拟芯片板块代表，统计板块 2025 年上半年业绩情况。

板块业绩：行业有所复苏，Q2 业绩实现同比、环比增长。模拟芯片板块 2025 年上半年实现营收 245.02 亿元，同比+13.16%，实现归母净利润 5.03 亿元，同比+280.46%；分季度来看，板块 25Q2 实现营收 135.82 亿元，同比+17.66%，环比+24.38%，25Q2 实现归母净利润 4.20 亿元，同比+70.90%，环比+408.87%。

图 28：模拟芯片板块 2021H1-2025H1 营收情况

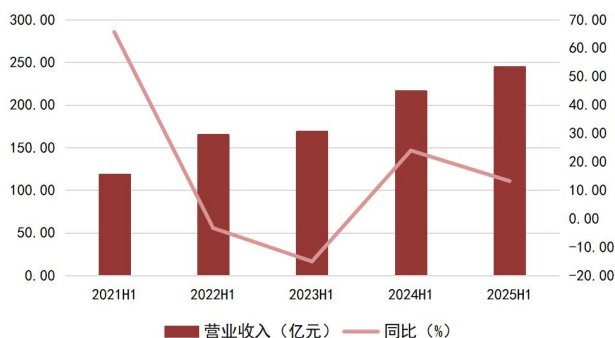
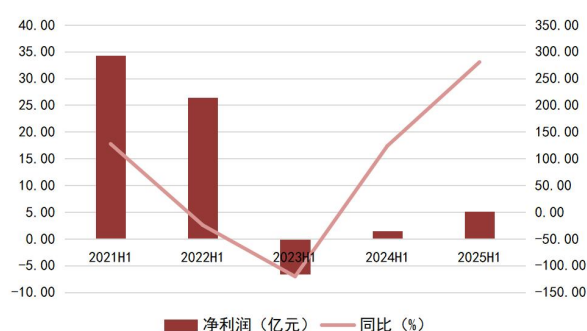


图 29：模拟芯片板块 2021H1-2025H1 归母净利润情况

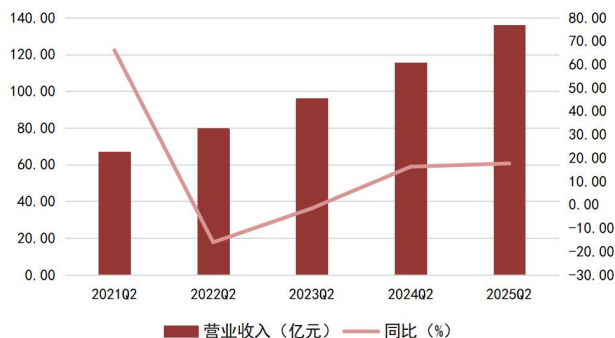


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

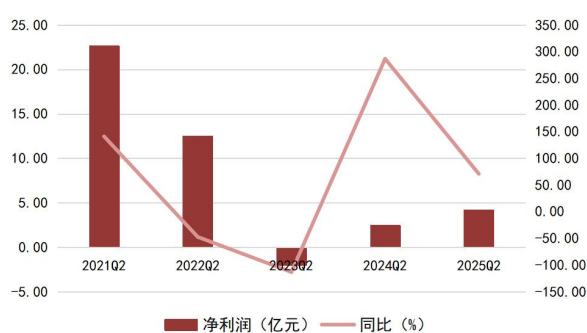
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 30：模拟芯片板块 2021Q2-2025Q2 营收情况

图 31：模拟芯片板块 2021Q2-2025Q2 归母净利润情况



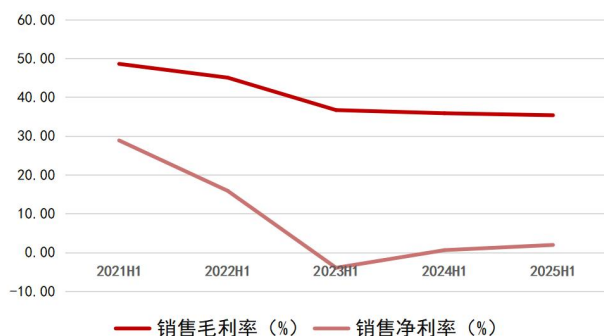
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所



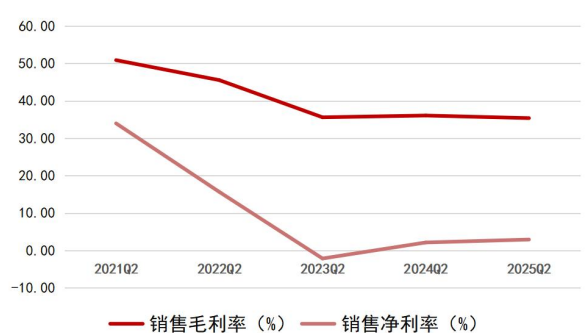
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

盈利能力：销售毛利率同比下滑，销售净利率同比提高。盈利能力方面，模拟芯片板块 2025 年上半年销售毛利率为 35.34%，同比下降 0.51pct，销售净利率为 1.91%，同比提高 1.31pct，分季度来看，模拟芯片板块 25Q2 销售毛利率为 35.36%，同比-0.69pct，销售净利率为 2.91%，同比+0.79pct。

图 32：模拟芯片板块 2021H1-2025H1 毛利率、净利率 (%)图 33：模拟芯片板块 2021Q2-2025Q2 毛利率、净利率



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

综上所述，2025 年上半年消费电子持续复苏，且通信、工业、汽车等领域需求有所回暖，叠加业内厂商积极推进库存去化，带动模拟芯片行业景气转暖，业内主要企业 25Q2 营收、归母净利润均实现同比、环比提升。此外，以圣邦、纳芯微为代表的部分企业在工业、车规级芯片等领域加速国产替代，市场份额有所提升。

部分模拟芯片企业业绩梳理

圣邦股份（300661）：公司 2025 年上半年实现营收 18.19 亿元，同比增长 15.37%，实现归母净利润 2.01 亿元，同比增长 12.42%，对应 25Q2 营收为 10.29 亿元，同比增长 21.46%，环比增长 30.35%，单季度收入创历史新高；对应 25Q2 归母净利润为 1.41 亿元，同比增长 13.52%，环比增长 136.04%。报告期内，公司两大业务进展顺利，其中电源管理芯片 2025 年上半年实现营收 11.27 亿元，同比增长 8.16%，信号链产品 2025 年上半年实现营收 6.92 亿元，同比增长 28.57%。毛利率方面，公司 25H1 信号链产品毛利率为 58.85%，同比提高 1.55pct，电源管理产品销售毛利率为 44.64%，同比下降 5.11pct。

思瑞浦（688536）：公司 2025 年上半年实现营收 9.49 亿元，同比增长 87.33%，实现归母净利润 0.66 亿元，同比增长 200.07%，对应 25Q2 营收为 5.27 亿元，同比增长 71.96%，环比增长 25.03%，对应 25Q2 归母净利润为 0.50 亿元，同比增长 404.32%，环比增长 222.07%。2025 年上半年，受行业去库存、市场需求恢复，及公司推出更多新产品、加大市场拓展的影响，公司工业、汽车、通信、消费电子四大主要市场销量及收入均取得增长。分产品来看，2025 年上半年，公司信号链芯片实现销售收入 6.43 亿元，同比增长 53.66%；电源管理芯片实现销售收入 3.06 亿元，同比增长 246.11%。

2.4 半导体封测：25H1 封测行业景气度稳步回升，AI 加大先进封装需求

选取申万半导体行业下的三级行业——“集成电路封测”作为半导体封测代表，统计板块 2025 年上半年业绩情况。

板块业绩：25Q2 营收、归母净利润实现同比、环比增长。半导体封测板块 2025 年上半年实现营收 458.64 亿元，同比+18.73%，实现归母净利润 15.42 亿元，同比 3.50%；分季度来看，板块 25Q2 实现营收 239.67 亿元，同比+14.28%，环比+9.46%，25Q2 实现归母净利润 11.11 亿元，同比+1.81%，环比+157.85%。

图 34：半导体封测板块 2021H1-2025H1 营收情况

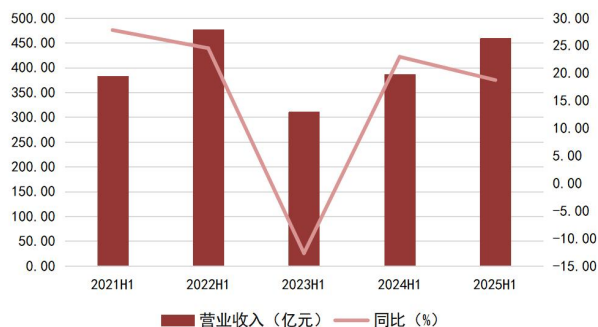
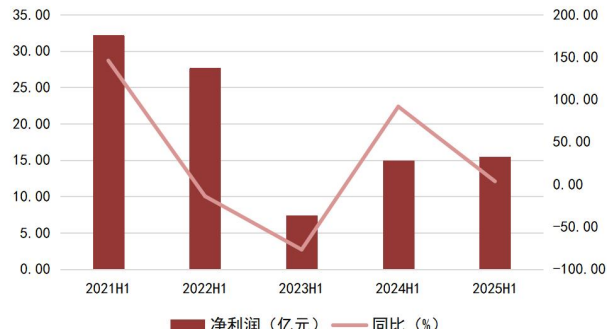
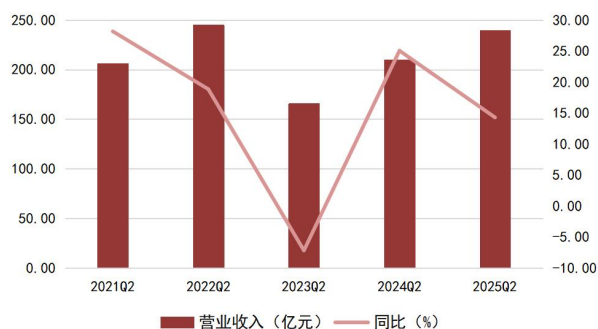


图 35：半导体封测板块 2021H1-2025H1 归母净利润情况



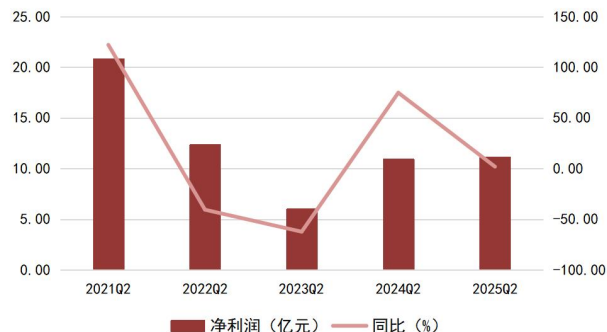
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 36：半导体封测板块 2021Q2-2025Q2 营收情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 37：半导体封测板块 2021Q2-2025Q2 归母净利润情况



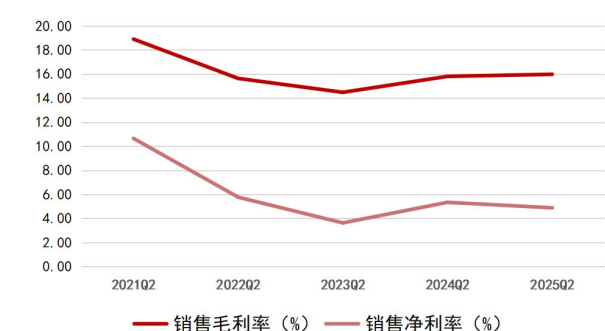
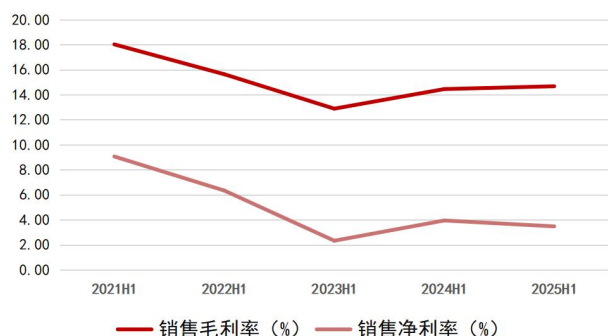
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

盈利能力：25Q2 销售毛利率同比提高，销售净利率略有下滑。盈利能力方面，半导体封测板块 2025 年上半年销售毛利率为 14.67%，同比+0.23pct，销售净利率为 3.47%，同

比-0.47pct，板块 2025 年二季度销售毛利率为 15.98%，同比+0.17pct，销售净利率为 4.88%，同比-0.46pct。

图 38：半导体封测板块 2021H1-2025H1 毛利率、净利率图 39：半导体封测板块 2021Q2-2025Q2 毛利率、净利率



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

综上所述，2025 年上半年，全球半导体市场呈现周期复苏，手机芯片、汽车芯片等国产化速度加快，得益于半导体行业景气度整体回升，封测市场需求稳步提升，带动板块 25Q2 营收、归母净利润实现同比、环比增长。此外，人工智能、智能汽车等新兴应用对封装技术提升更高要求，驱动先进封装占比提升，板块盈利能力有望持续改善。

部分半导体封测企业业绩梳理

长电科技（600584）：公司 2025 年上半年实现营收 186.05 亿元，同比增长 20.14%，实现归母净利润 4.71 亿元，同比下降 23.98%，对应 25Q2 营收为 92.70 亿元，同比增长 7.24%，环比下降 0.70%，对应 25Q2 归母净利润为 2.67 亿元，同比下降 44.75%，环比增长 31.50%。在半导体行业复苏背景下，公司 2025 年上半年营收实现稳健增长，但受在建工厂处于产品导入期尚未形成量产收入、财务费用上升与部分原材料价格波动影响，公司 25Q2 盈利能力承压，归母净利润同比有所下滑。

通富微电（002156）：公司 2025 年上半年实现营收 130.38 亿元，同比增长 17.67%，实现归母净利润 4.12 亿元，同比增长 27.72%，对应 25Q2 营收为 69.46 亿元，同比增长 19.80%，环比增长 14.01%，对应 25Q2 归母净利润为 3.11 亿元，同比增长 38.60%，环比增长 206.45%，单季度营收、净利润均创历史新高。盈利能力方面，公司 25Q2 单季度销售毛利率为 16.12%，同比+0.12pct，环比+2.92pct，单季度销售净利率为 5.15%，同比+0.85pct，环比+3.06pct。2025 年上半年，全球半导体市场呈现周期复苏，手机芯片、汽车芯片等国产化速度加快，公司在手机、家电、车载等应用领域提升市场份额，加快全球化布局，驱动营收、净利润实现同比增长。

华天科技（002185）：公司 2025 年上半年实现营收 77.80 亿元，同比增长 15.81%，实现归母净利润 2.26 亿元，同比增长 1.68%，对应 25Q2 营收为 42.11 亿元，同比增长 16.59%，

环比增长 18.01%，对应 25Q2 归母净利润为 2.45 亿元，同比增长 47.86%，环比增长 1422.32%。2025 年上半年，得益于半导体行业景气度的整体回升，封测行业市场需求稳步提升，公司订单和经营业绩稳步增长。报告期内，公司持续关注市场发展和客户需求，识别和关注客户业务增长关键因素，聚焦重点客户服务工作，与战略客户升级战略伙伴关系，汽车电子、存储器订单实现大幅增长。

2.5 集成电路制造：主要晶圆厂产能利用率稳步提升，板块营收、净利润实现同比增长

选取申万半导体行业下的三级行业——“集成电路制造”作为集成电路制造板块代表，统计板块 2025 年上半年业绩情况。

板块业绩：主要晶圆厂产能利用率提升，板块 25Q2 营收、净利润实现同比、环比增长。
集成电路制造板块 2025 年上半年实现营收 551.29 亿元，同比+19.37%，实现归母净利润 28.14 亿元，同比+44.65%；分季度来看，板块 25Q2 实现营收 278.57 亿元，同比+16.14%，环比+2.14%，25Q2 实现归母净利润 14.22 亿元，同比+9.33%，环比+2.12%。

图 40：集成电路制造板块 2021H1-2025H1 营收情况

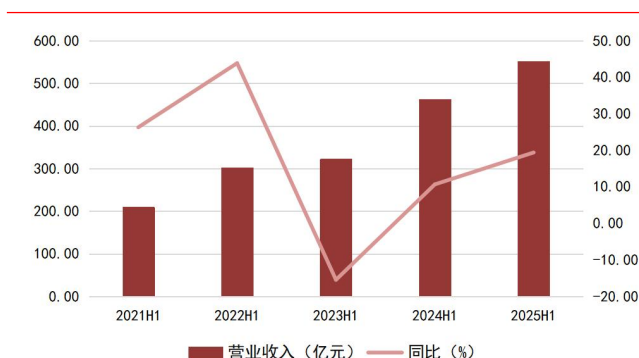
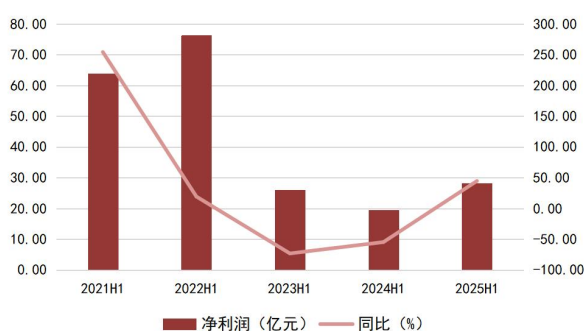
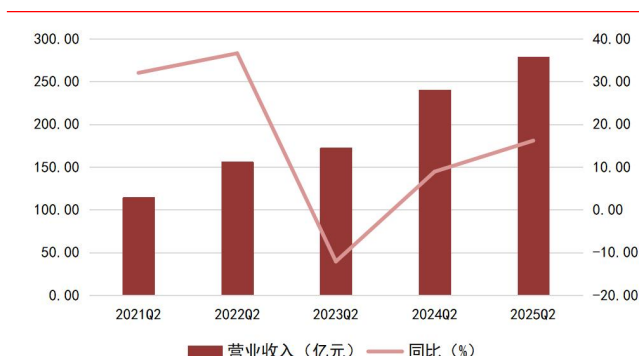


图 41：集成电路制造板块 2021H1-2025H1 归母净利润情况



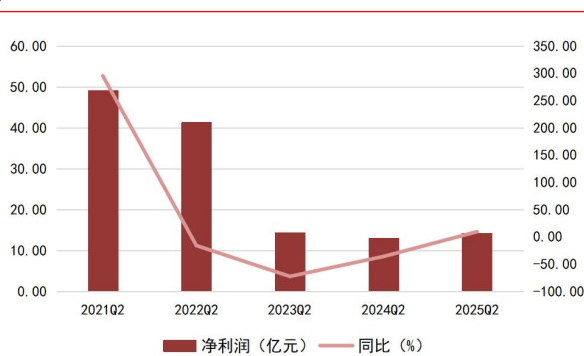
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 42：集成电路制造板块 2021Q2-2025Q2 营收情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 43：集成电路制造板块 2021Q2-2025Q2 归母净利润情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

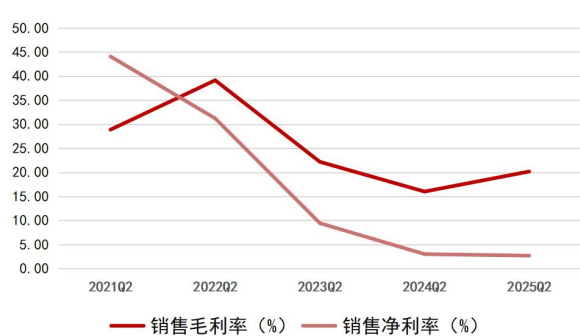
盈利能力：Q2 销售毛利率实现同比提升，净利率基本保持稳定。盈利能力方面，集成电路制造板块 2025 年上半年销售毛利率、销售净利率分别为 21.00%和 4.05%，相比上年同期分别提高 5.11pct 和 3.06pct，板块 25Q2 销售毛利率为 20.16%，同比提高 4.16pct，25Q2 销售净利率为 2.68%，同比下降 0.33pct。

图 44：集成电路制造板块 2021H1-2025H1 毛利率、净利率（%）



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 45：集成电路制造板块 2021Q2-2025Q2 毛利率、净利率



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

根据 Trendforce 集邦咨询最新调查，因国内市场消费补贴引发的提前备货效应，以及下半年智能手机、笔电/PC、Server 新品所需带动，全球整体晶圆代工产能利用率与出货量转强，全球前十晶圆代工厂 2025 年二季度合计营收达 417.18 亿美元，创历史新高，环比增长 14.6%。其中，中芯国际、华虹集团 25Q2 营收分别为 22.09 亿美元、10.61 亿美元，分列全球第三位、第六位。

图 46：2025 年二季度全球前十大晶圆代工厂营收排名（单位：百万美元）

Ranking	Company	Revenue			Market Share	
		2Q25	1Q25	QoQ	2Q25	1Q25
1	台积电(TSMC)	30,239	25,517	18.5%	70.2%	67.6%
2	三星(Samsung)	3,159	2,893	9.2%	7.3%	7.7%
3	中芯国际(SMIC)	2,209	2,247	-1.7%	5.1%	6.0%
4	联电(UMC)	1,903	1,759	8.2%	4.4%	4.7%
5	格芯(GlobalFoundries)	1,688	1,585	6.5%	3.9%	4.2%
6	华虹集团(Huahong Group)	1,061	1,011	5.0%	2.5%	2.7%
7	世界先进(VIS)	379	363	4.3%	0.9%	1.0%
8	高塔半导体(Tower)	372	358	3.9%	0.9%	0.9%
9	合肥晶合(Nexchip)	363	353	2.9%	0.8%	0.9%
10	力积电(PSMC)	345	327	5.4%	0.8%	0.9%
前十大合计		41,718	36,413	14.6%	97%	97%

数据来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

注1：三星仅计入晶圆代工事业部的营收；

注2：华虹集团包含华虹宏力、上海华力及集团其他事业的营收；

注3：力积电仅计入存储器与逻辑代工业务的营收。

部分集成电路制造企业业绩梳理

中芯国际（688981）：公司 2025 年上半年实现营收 323.48 亿元，同比增长 23.14%，实现归母净利润 23.01 亿元，同比增长 39.76%，对应 25Q2 营收为 160.47 亿元，同比+17.34%，环比-1.56%，对应 25Q2 归母净利润为 9.44 亿元，同比-16.95%，环比-30.37%。2025 年上半年，晶圆代工下游需求有所复苏，带动公司产能利用率提升，公司 25Q2 晶圆出货量环比增长 4.3%，但平均销售单价下滑 6.4%，主要因为 8 英寸低价产品占比提升拉低整体均价；此外，折旧与研发费用刚性上升也拖累了企业利润。业绩指引方面，公司预计 25Q3 收入环比增长 5%-7%，出货量和 ASP 均环比提升；毛利率 18-20%，环比基本持平，产出增加抵消折旧上升影响。

华虹公司（688347）：公司 2025 年上半年实现营收 80.18 亿元，同比增长 19.09%，实现归母净利润 0.74 亿元，同比下降 71.95%，对应 25Q2 营收为 41.05 亿元，同比+19.51%，环比+4.92%，对应 25Q2 归母净利润为 0.52 亿元，同比+19.41%，环比+126.47%。2025 年上半年，公司多个特色工艺平台（如功率器件、模拟与电源管理）实现营收同比、环比两位数增长，展现出强劲市场需求。受益下游模拟、存储、电源管理、逻辑产品需求增长，公司 25Q2 产能利用率进一步提升至 108.3%，环比提高 5.6 个百分点。业绩指引方面，公司预计 25Q3 实现营收 6.2 亿-6.4 亿美元，对应中值环比增长 11.3%，毛利率 10%-12%，中值环比提高 0.1pct。

3. 投资建议

投资建议：AI、国产替代双轮驱动，维持对板块超配评级。2025 年上半年半导体行业处于上行周期，人工智能、国产替代双轮驱动板块 Q2 营收、归母净利润实现同比增长，且盈利能力有所提高。展望下半年，人工智能需求仍然旺盛，内资晶圆厂先进制程扩产持续推进，而设备、材料、AI 算力、存储等领域国产替代进程有望继续深化，龙头企业有望通过并购重组与 H 股上市加快资源整合，进一步增强综合竞争力。

建议关注标的：

- **半导体设备与材料：**北方华创（002371）、中微公司（688012）、华海清科（688120）、拓荆科技（688072）、长川科技（300604）、鼎龙股份（300054）、江丰电子（300666）；
- **存储芯片：**兆易创新（603986）、澜起科技（688008）、佰维存储（688525）；
- **模拟芯片：**圣邦股份（300661）、思瑞浦（688536）；
- **先进封装与测试：**长电科技（600584）、通富微电（002156）、伟测科技（688372）；
- **SoC&CIS：**乐鑫科技（688018）、恒玄科技（688608）、瑞芯微（603893）、豪威集团（603501）、思特威（688213）。
- **算力芯片：**海光信息（688041）
- **晶圆代工：**中芯国际（688981）

4. 风险提示

贸易形势不确定性导致下游需求存在不确定性的风险、国产替代进程不及预期的风险、产能持续释放导致竞争加剧的风险等。

表 1：重点公司盈利预测及投资评级（截至 2025/9/3）

股票代码	股票名称	股价 (元)	EPS (元)			PE (倍)			评级	评级变动
			2024A	2025E	2026E	2024A	2025E	2026E		
002371	北方华创	373.43	10.56	10.13	13.06	35.35	36.86	28.59	买入	维持
688012	中微公司	212.00	2.60	3.69	5.07	81.54	57.39	41.81	买入	维持
688120	华海清科	120.48	4.31	3.84	4.86	27.95	31.42	24.79	买入	维持
688072	拓荆科技	186.50	2.46	3.61	5.06	75.81	51.68	36.89	买入	维持
300604	长川科技	59.36	0.72	1.41	1.88	82.44	42.25	31.60	买入	维持
300054	鼎龙股份	30.57	0.55	0.75	0.98	55.58	40.91	31.21	买入	维持
300666	江丰电子	77.41	1.51	2.00	2.61	51.26	38.65	29.70	买入	维持
603986	兆易创新	171.09	1.66	2.27	3.04	103.07	75.37	56.28	买入	维持
688008	澜起科技	112.49	1.25	1.92	2.43	89.99	58.59	46.29	买入	维持
688525	佰维存储	67.53	0.37	0.95	1.57	182.51	71.08	43.07	买入	维持
300661	圣邦股份	72.72	1.06	1.31	1.82	68.80	55.51	39.96	买入	维持
688536	思瑞浦	150.04	-1.50	1.03	2.27	-100.03	145.57	66.18	买入	维持
600584	长电科技	38.35	0.90	1.12	1.41	42.61	34.38	27.26	买入	维持
002156	通富微电	35.36	0.45	0.78	0.91	78.58	45.33	38.86	买入	维持
688372	伟测科技	81.01	1.13	1.48	2.05	71.69	54.87	39.43	买入	首次
688018	乐鑫科技	187.71	3.07	3.31	4.42	61.13	56.70	42.45	买入	维持
688608	恒玄科技	260.70	3.82	5.12	7.20	68.29	50.88	36.22	买入	维持
603893	瑞芯微	206.57	1.42	2.41	3.18	145.47	85.56	64.94	买入	维持
603501	豪威集团	136.00	2.77	3.70	4.79	49.10	36.76	28.39	买入	维持
688213	思特威	100.50	0.98	2.18	3.18	102.21	46.00	31.62	买入	维持
688041	海光信息	194.98	0.83	1.26	1.76	234.92	154.75	110.78	买入	维持
688981	中芯国际	114.76	0.46	0.64	0.78	249.48	179.06	147.05	买入	维持

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

注：北方华创、兆易创新、澜起科技、通富微电、圣邦股份、豪威集团、海光信息 2025/2026 年 EPS 采用报告预测值，其他公司采用同花顺一致预测值

东莞证券研究报告评级体系：

公司投资评级	
买入	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 15%以上
增持	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 5%-15%之间
持有	预计未来 6 个月内，股价表现介于市场指数±5%之间
减持	预计未来 6 个月内，股价表现弱于市场指数 5%以上
无评级	因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，导致无法给出明确的投资评级；股票不在常规研究覆盖范围之内
行业投资评级	
超配	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 10%以上
标配	预计未来 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±10%之间
低配	预计未来 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

说明：本评级体系的“市场指数”，A 股参照标的为沪深 300 指数；新三板参照标的为三板成指。

证券研究报告风险等级及适当性匹配关系	
低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	主板股票及基金、可转债等方面的研究报告，市场策略研究报告
中高风险	创业板、科创板、北京证券交易所、新三板（含退市整理期）等板块的股票、基金、可转债等方面的研究报告，港股股票、基金研究报告以及非上市公司的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

投资者与证券研究报告的适当性匹配关系：“保守型”投资者仅适合使用“低风险”级别的研报，“谨慎型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中低风险”的研报，“稳健型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中风险”的研报，“积极型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中高风险”的研报，“激进型”投资者适合使用我司各类风险级别的研报。

证券分析师承诺：

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点，不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系，没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益，或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

声明：

东莞证券股份有限公司为全国性综合类证券公司，具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下，本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有，未经本公司事先书面许可，任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发，需注明本报告的机构来源、作者和发布日期，并提示使用本报告的风险，不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的，应当承担相应的法律责任。

东莞证券股份有限公司研究所

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码：523000

电话：（0769）22115843

网址：www.dgzq.com.cn